电子科技大学“先进电子电路及系统集成”
微专业招生简章

一、微专业介绍

电子电路被誉为电子产品之母，在电子信息产业中发挥着举足轻重、承上启下的作用。目前，行业面临着突破封装载板、高阶 HDI（高密度互连）等行业前沿产品产业化的重要节点，电子电路行业处于人才极为紧缺的状态，创新型人才需求紧迫。

“先进电子电路及系统集成”微专业瞄准国家电子信息产业战略需求，填补“电子电路”学科空白，聚焦电子电路全产业链（设计、材料、制造、封装测试）的核心技术能力培养。本微专业致力于构建系统化人才培养体系，解决行业研发人员知识碎片化、创新能力不足的痛点，直接服务于年产值超 4000 亿且持续扩张的电子电路产业，为突破封装载板、高阶 HDI 等前沿技术产业化瓶颈提供人才支撑。

二、培养目标

“先进电子电路及系统集成”微专业通过系统性知识体系搭建、双导师制项目驱动、前沿技术创新思维、跨国课堂培养等，培养掌握电子电路系统设计、工艺开发与工程管理的复合型创新人才。通过系统训练，使学生具备扎实的电路设计、先进电子电路制造及封装技术、电子材料与电子化学品研发等创新能力，同时具备一定的跨国项目协作与技术管理的综合素质。

三、师资力量

本微专业由材料与能源学院牵头建设，组建跨学院、校企联合教师团队，由教学经验丰富、学术水平高的国际化高端教师团队担任授课及培养导师。微专业负责人兼任中国电子电路行业协会教育工作委员会主任，已联合国内多家电子电路上市公司就人才培养达成一致，近年来已聘任行业相关专家 8 名，可为校外课程开设提供师资保障。

四、招生对象和计划

综合素质优秀，对本微专业感兴趣的材料类、化学类以及电子信息类大二、大三本科生均可报名。招生人数不超过20人。

五、学制、学分及证书

学制：1年

学分：10学分

微专业是非学历教育，不授予学位，不收取费用。学生完成微专业的相应课程并达到学习要求，由学校统一发放微专业学习证明；微专业课程成绩单独管理，在微专业成绩单上显示，不计入主修专业，不影响评奖评优和毕业资格。

六、课程设置

本微专业以“产业链需求倒推课程设计”为逻辑主线，围绕电子电路上中下游（设计→材料→制造→封装）核心知识体系需求进行课程体系设计，并且开设以行业专家为主的工程师课程，扩展学生的行业技术与国际化视野。课程基本设置见表1。

表1 微专业课程设置情况

课程名称	学时	学分	开课学院	开课学期	开课方式	修读要求
印制电路原理和工艺（含实践）	32	2	材料与能源学院	秋	线下	必修
试验优化设计	32	2	材料与能源学院	秋	线下	必修
电路设计EDA	20	1	材料与能源学院	秋	线下	必修
微电子工艺与封装	32	2	材料与能源学院	春	线下	必修
电子工艺化学原理（含电子材料与化学品）	32	2	材料与能源学院	春	线下	必修
工程师课程	16	1	材料与能源学院	春	线上+线下	必修

七、教学安排

本微专业单独编班（最低开班人数 10 人）、单独开课。计划于 2026 年秋季学期开设印制电路原理和工艺（含实践）、试验优化设计、电路设计 EDA 三门课程，2027 年春季学期开设微电子工艺与封装、电子工艺化学原理（含电子材料与化学品）、工程师课程三门课程，具体排课时间待录取名单确认后另行通知。

八、报名、选拔方式

（一）报名

2026 年 9 月 30 日前，扫码填写报名资料。

（二）选拔方式

评审后择优录取，具体安排报名结束后另行通知。

九、联系方式

联系人：张老师　　**电　话：**028-61831073

邮　箱：zwj@uestc.edu.cn　　**地　点：**六号科研楼 A323

、

电子科技大学材料与能源学院

2026 年 8 月 31 日